

# 盛美半导体设备（上海）股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）认为提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司特制定2024年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象。主要措施如下：

### 一、聚焦经营主业，提升核心竞争力

成立以来，公司始终致力于为全球集成电路行业提供创新领先的设备和工艺解决方案，坚持差异化竞争与原始创新驱动发展战略。通过不懈自主研发，公司已建立起完善的知识产权体系，拥有国际先进的前道半导体工艺设备，涵盖半导体清洗设备、半导体电镀设备、立式炉管系列设备、涂胶显影Track设备、等离子体增强化学气相沉积PECVD设备、无应力抛光设备、后道先进封装设备以及硅材料衬底制造工艺设备等多个领域的产品线。其中，在清洗设备及镀铜设备领域，公司占据国内龙头企业地位，凭借深厚的工艺技术积累、高效的供应链管理和卓越的制造能力，已成为中国大陆少数具有国际竞争力的半导体设备供应商之一，产品深受国内外主流半导体厂商的认可，并积累了良好的市场口碑。公司本着技术差异化、产品平台化和客户全球化的战略目标，不断开拓国内及国际市场，跻身全球半导体设备企业第一梯队。

2024年，公司将专注于主营业务的深耕细作，持续加大研发投入力度，不断提升产品的市场竞争力和技术领先地位，从而全面提升公司的核心竞争力、盈利能力以及品牌影响力。具体包括以下几个方面：

#### 1、加强客户拓展

根据中银证券专题报告的历年累计数据统计显示，公司清洗设备的国内市占

率为23%；而Gartner 2022年数据显示，公司在全球单片清洗设备的市场份额已升至7.2%。2024年，公司将重点面向中国大陆需求，提高现有产品在已有客户的市场占有率，加快新客户产品验证的进程，力图实现多客户、多产品同步推进验证工作。同时，公司将在已进入韩国、中国台湾地区、美国、欧洲市场的基础上，密切关注全球范围内芯片制造生产线的投产计划，紧跟全球半导体行业第一梯队的大客户，提高中国大陆以外国际市场的销售比例。

## 2、持续加大研发投入

公司将持续加大研发投入力度，保持2024年研发投入占营业收入的比例不低于15%。为加快产品研发及验证进程，公司借鉴国际半导体龙头企业的先进经验，制定了建设工艺测试试验线的计划。国际半导体设备龙头企业例如Applied Materials等早在多年前就已建设自有工艺测试试验线，在产品研发方面取得良好的成果。公司计划在未来4年内，通过模拟晶圆制造厂生产环境，配置必需的研发测试仪器设备结合自制的多种工艺设备，打造集成电路设备研发和工艺测试平台。工艺测试试验线完成建设后，可完善公司研发测试环节的产业布局，提升研发测试能力，为公司产品从研发到定型提供更加完善的测试配套服务。

公司所处的半导体设备行业具有产品技术升级快、研发投入大等特点，国际领先的同行业公司均在研发上投入了大量资金，例如Applied Materials 2023财年的研发投入为31亿美元，LAM 2023财年的研发投入为17亿美元，TEL 2022财年研发投入为14亿美元，相比之下公司2023年研发投入为6.58亿元人民币，与国际领先的半导体公司仍有较大数量级的差距。公司为了跻身国际第一梯队行列，必须持续提升在技术研发方面的投入水平，进一步缩小与海外同行业巨头在研发投入方面的差距。同时，参考国内半导体设备上市公司通过再融资增强公司研发实力的方式，2024年1月，公司披露《盛美半导体设备（上海）股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》，拟投资“研发和工艺测试平台建设项目”、“高端半导体设备迭代研发项目”等，上述项目有助于提升公司整体研发实力，符合公司长期发展规划及业务布局。

此外，研发人员是技术突破和产品创新的基础和保障，公司不断完善研发管理机制及以期权和奖金为主的创新激励机制，对在技术研发、产品创新、专利申请等方面做出突出贡献的技术研发人员给予奖励，激发技术研发人员的工作热情。

公司在主营业务各项产品方面，均有深厚的技术积累，并将持续增大研发深度，拓宽研发广度。对于集成电路清洗设备，公司在多年研发的基础上，持续提升技术水平，优化现有产品性能，并积极探索新的应用领域，提升在中国市场和全球市场的占有率；对于高端半导体电镀设备，公司已取得突破并获得大量订单，未来将进一步完善产品性能和功能，以及推进新的应用，夯实国际市场地位；对于先进封装湿法设备，公司布局的设备线种类齐全，将加大相关研发投入和市场开拓，以导入全球市场。对于立式炉管、涂胶显影Track设备及PECVD设备等领域，公司亦已具有多年的技术积累，在此基础上，公司将持续加大对上述项目的研发投入。未来几年，公司重点投入的研发内容与预计取得的成果如下：

序号	项目名称	研发内容	预计取得的成果
1	集成电路清洗系列设备	一方面进一步迭代研发，另一方面拓展新的清洗设备类型，从而达到清洗工艺覆盖超过95%以上工艺应用，成为全球有竞争力的清洗设备厂商。	在现有产品、技术及研究工作的基础上，开发用于逻辑制程、3D NAND、DRAM的下一代清洗设备；将槽式清洗设备的单次处理能力从50片提高至100片；开发Chiplet负压清洗设备、干法清洗设备，取得核心知识产品，并通过客户端验证
2	高端半导体电镀设备	一方面进一步迭代研发，另一方面拓展新的电镀设备类型，包括平板电镀设备，夯实全球有竞争力的电镀设备厂商地位。	在现有产品、技术及研究工作的基础上，将电镀设备的产能从84片/小时提高至100片/小时；将TSV深孔电镀设备的深宽比从10:1提高至20:1、开发针对515mmx500mm以及600mmx600mm面板级高密度扇出封装电镀设备，取得核心知识产品，并通过客户端验证
3	先进封装湿法设备	进一步提高先进封装湿法设备领域的技术水平，针对客户提出的新要求展开迭代研发，并拓展国际市场应用。	开发出针对先进封装技术的封装设备，包括带铁环薄膜的清洗和去胶设备，先进封装伯努利吸盘清洗设备
4	立式炉管设备	一方面进一步迭代研发，另一方面拓展新的炉管设备类型，成为全球有竞争力的立式炉管设备厂商。	研发出高介质常数原子层沉积炉管（High K）、低介质常数原子层沉积炉管（Low K）、多晶硅深孔填充炉管设备、氧化硅低压化学气相沉积炉管、锗硅沉积炉管设备和超高温扩散炉，取得核心知识产权，通过客户端验证
5	涂胶显影设备	利用公司全球独有的自主知识产权，一方面进一步迭代研发，另一方面拓展新的高产能涂胶显影设备类型，成为全球有竞争力的涂胶显影设备厂	开发出用于SOC、SOD等不同工艺的off line涂胶显影机、开发满足i-line工艺、300WPH及400WPH的KrF工艺、ArF浸润式工艺的涂胶显影设备，取得核心知识产权，通过客户端验证

		商。	
6	PECVD设备	利用公司全球独有的自主知识产权，一方面进一步迭代研发，另一方面拓展新型PECVD设备类型，成为全球有竞争力的PECVD设备厂商。	开发出等离子增强NF DARC设备、铜制程用NDC工艺PECVD设备、单片式PEALD设备，满足不同工艺的薄膜集成需求，取得核心知识产权，通过客户端验证

### 3、稳妥推进再融资项目

2024年1月，公司披露《盛美半导体设备（上海）股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》，向不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象发行A股股票，募集资金拟投向“研发和工艺测试平台建设项目”、“高端半导体设备迭代研发项目”以及补充流动资金。上述募投项目紧密围绕公司主营业务，是现有主营业务的延伸与拓展，符合公司长期发展规划及业务布局，顺应行业市场发展方向，与公司现有主营业务的发展具有较高的关联度。2024年，公司将结合市场情况稳妥推进再融资事项。上述募集资金投资项目系公司未来发展战略的重要方向，均系公司在已有研发基础上进行。公司将在2024年先行以自有资金投入项目，再融资的完成将大力加速公司的产品研发和验证工作。

### 4、关注半导体设备行业并购机遇

在高度竞争的产业形势下，公司考虑在有机成长的同时，通过投资并购国内外高端的半导体设备厂商或与知名设备厂商进行合作开发，使公司能够覆盖更多的产品品类、占领更多细分市场，为公司的长期可持续成长奠定基础。公司会重点考虑布局清洗设备、芯片制造、封装测试等领域的设备公司，以及其他化合物半导体领域设备公司。公司将积极围绕半导体设备行业上下游对优质企业进行投资，以提升公司在产业链上的协同性。

## 二、持续加强募投项目管理，提升公司科技创新能力

2021年11月，公司在上海证券交易所科创板挂牌上市，募集资金总额为人民币36.85亿元。上市以来，公司使用募集资金投入“盛美半导体设备研发与制造中心”、“盛美半导体高端半导体设备研发项目”、“盛美韩国半导体设备研发与制造中心”及补充流动资金等项目。目前，IPO募集资金使用比例已超过70%。在募集资金投入公司研发的背景下，公司2022年成功将立式炉管ALD设备推向国

内的两家关键客户；首台具有自主知识产权的涂胶显影Track设备Ultra LITH™成功出机，顺利向国内客户交付前道ArF工艺涂胶显影Track设备，已经开始着手研发KrF涂胶显影设备及浸润式ArF涂胶显影设备，首次推出等离子体增强化学气相沉积PECVD设备，支持逻辑和存储芯片制造。公司形成“清洗+电镀+先进封装湿法+立式炉管+涂胶显影+PECVD”的六大类业务版图。公司的营业收入由2021年的16.21亿元增长至2023年的38.88亿元，增幅达到139.89%；归属于上市公司股东的净利润由2021年的2.66亿元增长至2023年的9.11亿元，增幅达到241.98%。Gartner 2022年数据显示，公司在全球单片清洗设备的市场份额已升至7.2%。募集资金的投入以及公司在研发方面的投入，全面提升公司的核心竞争力、盈利能力以及品牌影响力。

2024年，公司将会持续加强募投项目管理，在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金管理规定，审慎使用募集资金，切实保证募投项目按规划顺利推进，以募投项目的落地促进公司主营业务发展，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。具体如下：

### **1、盛美半导体设备研发与制造中心项目**

该项目原计划使用IPO募集资金投入7亿元，已经全部投入完毕。经董事会和股东大会审议通过，公司使用超募资金向本项目增加投资额5亿元。截止2023年末，项目投入进度达到62.67%。2024年，公司将持续推动项目建设，预计于2024年6月达到可使用状态。临港研发制造中心生产厂房均为洁净厂房，可在制造、监测、测试及自动化立体仓储等方面实现智能化管理，极大地提升生产效率和产品良率；研发工艺测试洁净室建筑面积2,250平方米，公司将在其中配置多种自产设备产品作为工艺测试样机，搭建一套可用于研发与工艺测试的平台，为产品从研发到定型提供更加完善的测试配套服务，缩短新产品工艺验证和现有产品CIP改进工艺验证时间，提高研发效率。

### **2、盛美半导体高端半导体设备研发项目**

该项目是对公司现有或未来主要产品及核心技术的进一步开发、升级与创新，截至2023年末已完成投入。

### **3、高端半导体设备拓展研发项目**

截至2023年末，项目投入进度达到76.09%。该项目系在研发办公楼建设装修后购置研发设备开展研发，拟研发产品包括前道制造设备相关的干法设备拓展领

域产品和超临界CO2清洗干燥设备。2024年公司将继续按照计划推进设备购置安装及研发实施。

#### **4、盛美韩国半导体设备研发与制造中心**

由于该项目系使用超募资金投入新项目，自2023年2月启动，投入时间较短，且由于韩国当地政策原因，公司尚未与当地银行完成募集资金四方监管协议的协定与签署，因此截至2023年末超募资金尚未投入项目。为保证项目推进，公司已通过自有资金及当地银行贷款对项目进行投入。2024年，公司将加速募集资金的投入。

### **三、优化运营管理，提高经营质量与效率**

#### **1、提高经营效率**

2021年度、2022年度、2023年度，公司应收账款周转率分别为3.94、3.45及2.79；存货周转率分别为0.90、0.71及0.56。对于应收账款回款方面，公司未来将加快出货设备的工艺验收以提高回款速度，工艺、设计和售后服务等部门全力推进出货设备的快速验收，做好订单回款收款管理工作；对于存货周转方面，因为前两年供应链紧张，公司增加了部分交期较长原材料的备货量，随着供应链紧张的缓解，公司逐步消化这批存货。公司将建立更有效的库存管控体系，设置更合理的库存警戒线，以加快存货周转。

#### **2、提高盈利质量**

公司将持续进行市场拓展，继续履行客户全球化发展战略，在立足国内超大规模市场的前提下，秉承“国内、国外双循环”的发展理念，积极适应国际形势，加强全球市场的开拓，紧跟全球半导体行业第一梯队扩产脚步，着重在新产品、新应用拓展和新领域开发，提高公司在全球半导体设备市场占有率，提高公司盈利质量水平。公司预计2024年全年平均毛利率在40%-45%之间。

#### **3、提高资金效率**

由于公司所处半导体设备行业具有资金密集性的特征，产品技术升级快，研发投入大，并且研发投入早于应用层面，因此公司需要将有限的资金合理利用，使得研发成果与产品布局早于客户需求。公司将通过优化库存、加快新产品在客户端的验收、加快回款等举措，提高资金使用效率。

#### **4、优化考核要求**

公司在营运管理中采用关键指标管理，尤其在生产管理、材料管理、客户技术支持和设备运行表现方面设定了一系列的关键考核指标，覆盖了质量、效率、成本和安全等方面。2024年，公司将定期跟踪各项指标的执行情况，并根据统计结果和客户反馈进行内部讨论，制定出关键指标的改进要求。

## **5、人力资源**

继续引进和培养各方面的人才，同时吸纳全球高端人才，优化人才结构；公司将加强员工培训，继续完善员工培训计划，形成有效的人才培养和成长机制，通过内外部培训、课题研究等方式，提升员工业务能力与整体素质，在鼓励员工个性化、差异化发展的同时，培养团队意识，增强合作精神，打造世界级的一流人才团队，实现公司可持续发展；同时，公司未来还将根据具体情况对优秀人才持续实施股权或期权激励，将公司利益、个人利益与股东利益相结合，有效的激励优秀人才。

## **四、完善公司治理，推动公司高质量发展**

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，将持续完善法人治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。具体方案如下：

### **1、加快落实独立董事制度改革**

公司将加快落实独立董事制度改革，优化审计机构选聘和内部审计管理，进一步加强对分、子公司的监管力度，确保公司合规经营。

### **2、完善内控建设**

结合公司实际情况，全面梳理原有管理制度，在符合内部控制要求的前提下，着眼于管理创新、建立适合本公司的内部控制管理体系，明确相关部门人员的职责和权限，推行全面管理，提倡全员参与，建立彼此连接、彼此约束的内控制度。

### **3、管理层约束**

公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，对职务消费行为进行约束，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司的利益，切实维护上市公司和全体股东的合法权益。

### **4、董监高相关培训**

公司董监高积极参与上交所等监管机构举办的各种培训，加强学习证券市场

相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律意识，推动公司持续规范运作。公司未来亦将全力支持董监高积极参与相关培训。

## **五、持续加强投资者沟通交流**

公司董事会办公室为公司与投资者沟通的专职部门，自上市以来，公司积极接听投资者专线，及时回复投资者邮箱以及“上证E互动”平台，在季度报告、半年度及年度报告披露后，在“上证路演中心”、“进门财经”等平台举办投资者交流会，对公司经营业绩进行说明，对定期报告进行解读，并在“盛美上海”公众号上以图文简报的形式对财务报告进行可视化展示。公司严格遵循法律法规和监管要求，执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。具体包括以下方面：

### **1、投资者线上交流活动**

未来，公司将继续保持与投资者积极的线上交流，每年通过“上证路演中心”、“进门财经”等平台举办不少于8次投资者线上交流会。

### **2、举办投资者接待日等活动**

2024年，在完成临港研发制造中心的建设后，公司将在临港研发制造中心举办投资者接待日及投资者座谈会，邀请投资者对临港研发制造中心进行参观，并与投资者面对面交流，对公司业务经营、发展规划以及临港研发制造中心的具体情况进行介绍。2025年起，公司每年度亦将持续举办此类投资者线下交流活动，上述线下活动的报名通知将在公司网站、公众号等官方渠道上及时发布。

### **3、完善投资者意见征询及反馈机制**

公司将持续完善投资者意见征询和反馈机制，提高信息披露的透明度，深入了解投资者的实际诉求，并通过各种渠道进行针对性回应。在合规的基础上，让投资者全面及时地了解公司的经营状况、发展战略等情况，加强与投资者的交流与沟通，增进投资者对公司的信任与支持。

## **六、持续完善投资者回报机制**

公司坚持稳健、可持续的分红策略，兼顾现金分红的连续性和稳定性，根据公司的盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素，制定合理的利润分配方案。2022年度，公司以总股本为基准，每10股派发现金红利3.72元（含税），共

计派发现金红利16,128.32万元（含税），占2022年度归属于上市公司股东净利润的24.13%。2024年2月27日，公司召开第二届董事会第九次会议，全票审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。2023年度，公司以总股本为基准，拟每10股派发现金红利6.27元（含税），共计派发现金红利27,318.85万元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的30%。公司2023年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。2024年1月26日，公司制定并披露《盛美半导体设备（上海）股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》，公司将根据公司的实际情况，制定相应的分红方案，维护广大股东的合法权益，并结合公司的经营状况和业务发展目标，充分利用分红后留存的未分配利润和自有资金，保证未来经营的稳健发展，实现业绩增长与股东回报的动态平衡，打造可持续发展的股东价值回报机制。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，推动公司“提质增效重回报”的行动，根据相关法律法规、规范性文件，基于对中国半导体产业以及公司未来发展的坚定信心，结合公司未分配利润情况，在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事长HUI WANG提议：未来3年（2024年至2026年）的现金分红，每年保持在当年归属于上市公司股东净利润的25%-30%之间。公司董事长HUI WANG提请公司董事会就本项提议予以研究，其本人承诺将在相关会议审议该事项时投“赞成”票。上述提议尚需提交董事会、股东大会审议通过后方可实施。

## 七、强化管理层与股东的利益共担共享约束以及“关键少数”的责任

### 1、强化股权激励及约束

公司制订了与公司经营业绩与研发进展紧密相关的激励计划。2023年4月，公司公布的2023年限制性股票激励计划，对公司核心员工共计515人授予限制性股票进行激励。激励计划的设定有助于促进公司发展、维护股东权益，为公司长远稳健发展提供机制和人才保障。而公司对激励计划亦设定了营业收入增长率与专利申请数两项公司层面业绩考核要求，和严密的绩效考核体系作为个人层面的业绩考核要求。其中，营业收入增长率指标系与Gartner等权威机构数据公布的全球前五大半导体设备企业营业收入增长率的比较；专利申请数指标系当年申请的发明专利数量；个人绩效考核要求系根据公司绩效评比相关规则对个人按照

“优秀”、“良好”、“中等”、“合格”以及“不合格”划分为五档。上述考核要求锚定公司经营状况、成长性、盈利能力等与投资者利益紧密相关的指标，并设定了具有一定挑战性的考核目标，有助于提升公司整体发展质量，增强投资者回报。2023年，公司已实现发明专利申请数164项，达到激励计划目标值；营业收入增长率为35.34%，对标企业营业收入增长率数据公布后可确定是否达到激励计划目标值。

## 2、引导董事、高管等增持公司股份

2024年1月29日，公司披露《盛美半导体设备（上海）股份有限公司关于公司董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》，公司董事、总经理王坚，副总经理陈福平，董事会秘书罗明珠基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，拟自2024年1月29日起6个月内增持公司股份，增持金额合计不低于人民币900万元且不超过人民币1,200万元。截至2024年1月29日，增持主体通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份95,738股，占公司总股本的0.0220%，增持金额合计为人民币775.48万元，已超过本次增持计划下限900万元的50%。

## 3、制订与公司经营挂钩的薪酬政策

公司为高级管理人员制订了与公司经营情况相挂钩的薪酬政策。高管薪酬由基本工资、绩效工资及年终奖金组成。公司依据每一季的经营业绩及盈利状况等KPI指标，结合个人及部门指标完成情况进行评估，确定高管每一季的绩效工资和当年的年终奖。绩效工资以及年终奖均与公司及个人KPI指标挂钩，公司KPI指标包括销售额、订单额、利润率、客户开发情况、生产计划、生产质量、研发项目、安全保障等，对公司经营进行全面评估，个人KPI亦根据高管的个人工作情况与业绩目标完成情况等多方面综合进行评级。2024年，公司将不断优化并持续执行高管薪酬方案，确保高管薪酬与公司经营情况挂钩。

## 八、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2024年2月27日